

2024年12月期 第3季度

決算説明資料



株式会社 RS Technologies

Prime3445

2024年11月11日

目录

01	公司概况	P.03
02	决算概况	P.12
03	中期经营规划 (24年至26年)	P.17
04	新业务 (LE System)	P.29
05	Appendix	P.34

公司概况

01

- 再生晶圆业务占全球市场33%份额的龙头企业^{*1}
- 与中国中央政府直辖国有企业合资, 全面进军PRIME晶圆业务
- 通过M&A将业务扩展到可以实现协同效果的相关业务领域

公司的名字	株式会社 RS Technologies
设 立	2010年12月10日
经 营 理 念	「爱护地球环境, 赢得世界各地客户的信赖, 坚持不懈创造挑战」
业 务 内 容	<ul style="list-style-type: none"> • 晶圆再生加工和销售 • PRIME晶圆的生产销售 • 面向半导体制造装置的消耗部件的制造和销售 • 超声波影像设备的销售 • 电子零件的销售等
总部所在地	东京都品川区大井1-47-1 NT大厦
制 造 基 地	宫城县、茨城县、台湾 (台南)、中国 (德州)、福岛县
资 本 金	56亿4300万日元 (截至2023年12月底)
董 事 长	方永义

主 要 合 并 子 公 司	有研半导体硅材股份有限公司 GRITEK (北京)	注册资本 10亿元人民币 出资比例 40.09% ^{*3} 上市 上海证券交易所 科创板
	艾尔斯半导体股份有限公司 (台湾)	资本 NT \$300 million 出资比例 100%
	股份公司 DG Technologies	资本 100百万日元 出资比例 100%
	株式会社Union Electronics	资本 27百万日元 出资比例 100%

^{*1}根据SEMI数据在本公司进行推算
^{*2}(二) 国有企业中受中央政府监管的企业。
^{*3}截至2023年12月末

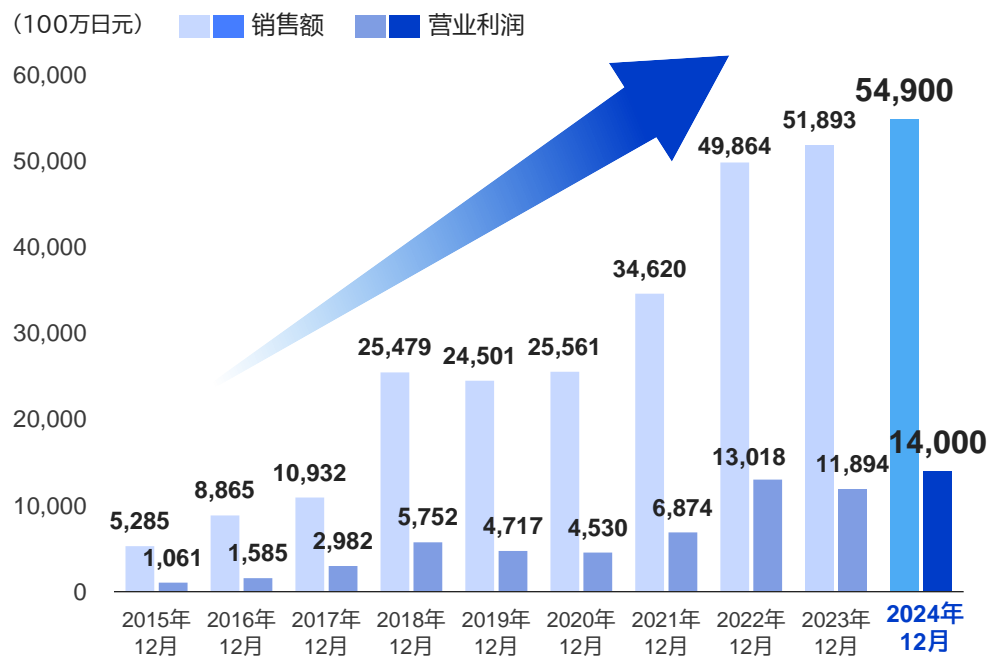
- 自设立以来, 在再生晶圆业务领域中确立了世界领先地位
2018年将中国大型PRIME晶圆制造商合并为控股子公司, 成为晶圆综合制造商

2010年 12月	以晶圆再生业务为主要业务, 设立株式会社RS Technologies	再生
2014年 2月	在台湾成立子公司——艾尔斯半导体股份有限公司(现为合并子公司)	再生
2015年 3月	在东京证券交易所创业板上市	
2016年 9月	变更为东京证券交易所主板上市企业	
2018年 1月	将中国PRIME晶圆制造商有研半导体材料有限公司(GRITEK)变为合并子公司	原生
2018年 5月	取得100%的株式会社Union Electronics的股份 (系Hitachi Power Devices的特约经销商)	半部
2018年 8月	设立山东有研半导体材料有限公司(GRITEK合并子公司、山东GRITEK)	原生
2019年 1月	取得株式会社DG Technologies(DG)100%股份	半部
2020年 2月	设立上海悠年半导体有限公司(上海悠年)	半部
2022年 4月	从东京证券交易所一部转移到Prime市场, 设立了提名薪酬委员会(可选)	
2022年 11月	GRITEK于上海证券交易所科创板上市	黄金
2023年 12月	承接“全钒液流电池(VRFB)”中使用的电解液制造业务	能源

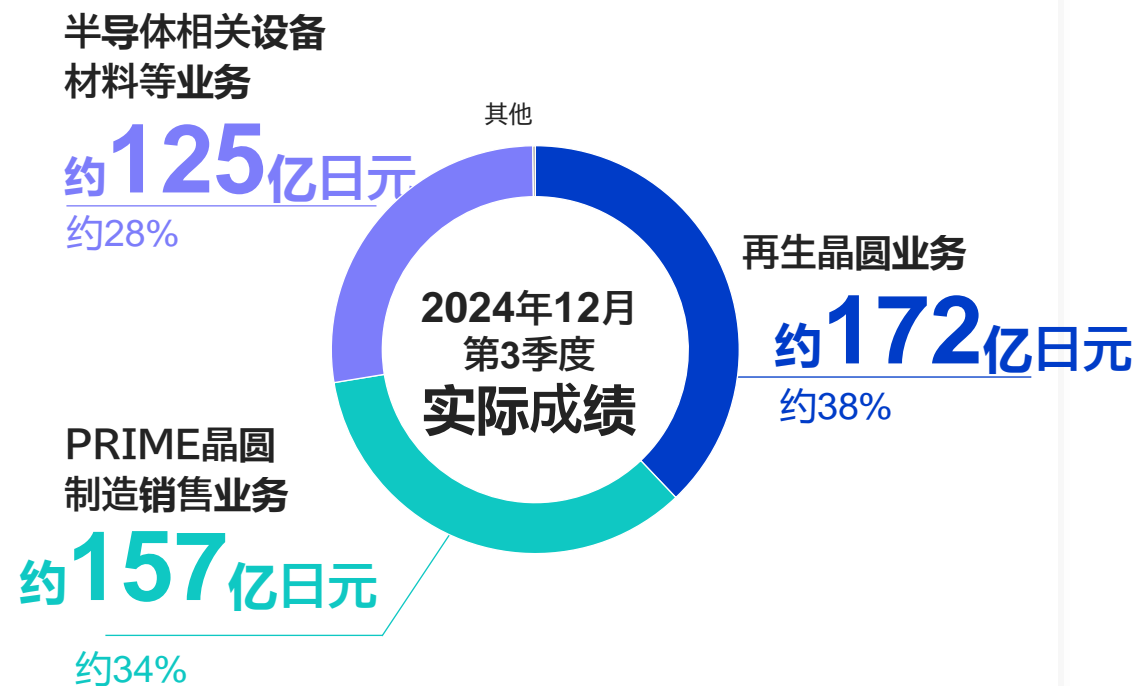
- 再生 再生晶圆业务
- 原生 PRIME晶圆业务
- 半部 半导体相关设备、部件等业务
- 能源 再生能源

- 再生晶圆业务+PRIME晶圆业务的综合晶圆制造商
- 扩大半导体相关设备·部件等业务领域
- 再生晶圆业务占全球市场占有率第一，PRIME晶圆业务以中国国内市场为中心开展业务

合并销售额及营业利润



细分业务领域销售额

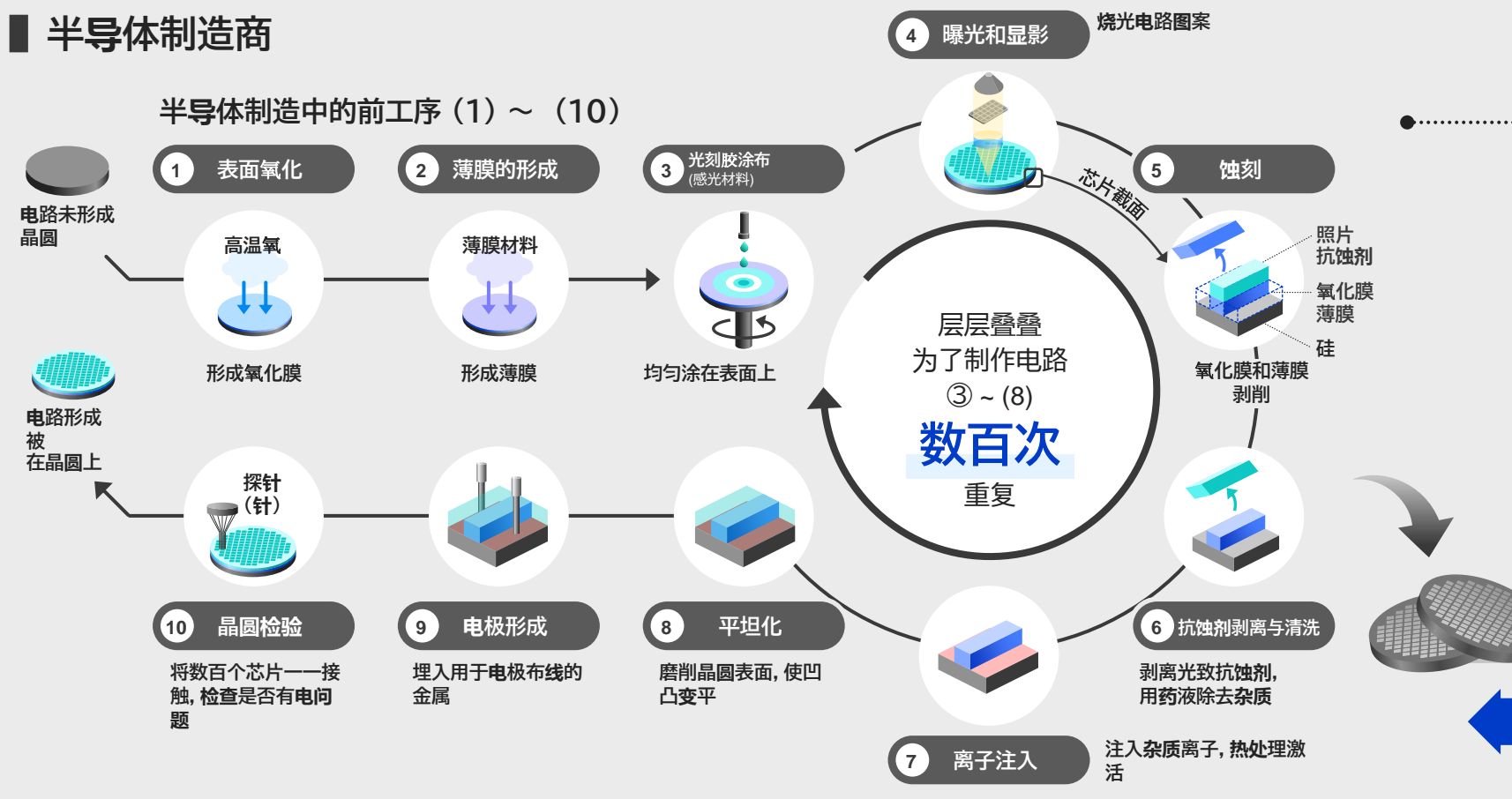


业务内容 (1/5 什么是再生晶圆)



- 再生晶圆主要是指在半导体制造中使用的测试晶圆进行再生加工的晶圆
- 再生后的晶圆可被反复使用。本公司的专有技术可以对应10次以上的再生回收,除了减轻环境负担外还有助于降低半导体制造商的成本

■ 半导体制造商



■ 公司

基本使用是所有的工艺流程

- Monitor晶圆 (用途:评价工艺和加工精度)
- dummy晶圆 (用途:提高精密加工的稳定性的)

公司对各种晶圆的再生加工后返还至半导体制造厂商

再生加工 (清洁到可重复使用的状态)

为了半导体制造
晶圆的再生是必不可少的

回收使用过的晶圆

发货

业务内容 (2/5 关于再生晶圆业务)



- 作为再生晶圆领域的全球供应商，实现了持续性的实绩增长

市场的特征

半导体行业持续增长

全球半导体市场规模从2023年到2030年不等。
复合年增长率:增长约10%，2030年
预计达到**1兆美元**※1

※1来源:SEMI日本“半导体市场预测”



经济波动对公司业务影响较小

- 适用于制造装置的组装等多种用途。
- 当经济衰退时客户的成本意识增加时，再生晶圆投入量增加
不易受硅循环影响

今后预计也会继续增长

实绩

实绩趋势

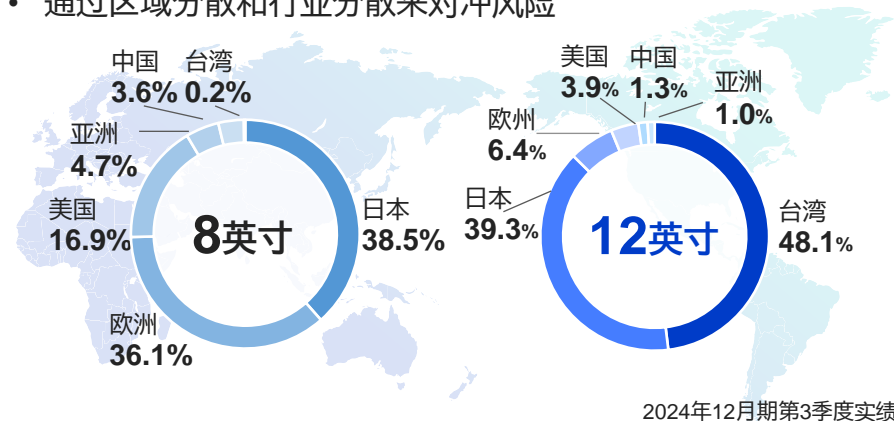
- 通过扩大制造基地等积极扩大生产能力实现大幅增长

(百万日元)



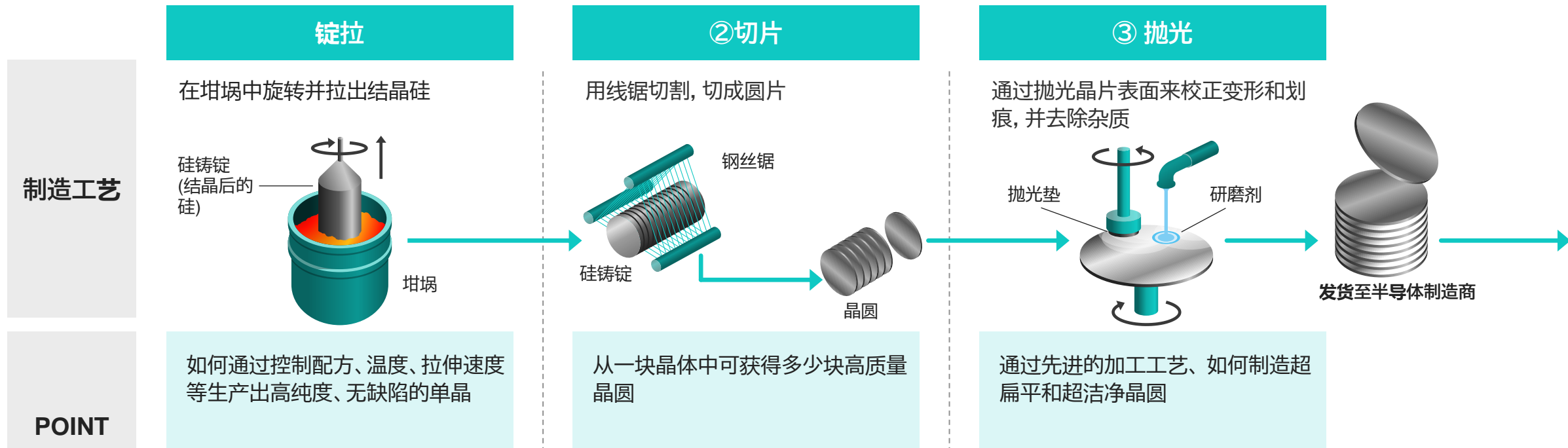
按地区划分的发货构成

- 确保日本, 台湾, 欧洲及北美等广泛客户
- 通过区域分散和行业分散来对冲风险



业务内容 (3/5 什么是PRIME晶圆)

- PRIME晶圆是指作为半导体基板材料的硅晶圆
- 使用Eleven Nine (纯度为99.99999999%) 的硅, 拥有目前地球上存在的物质中最高的平坦度



所有工艺流程都需要极致的结晶技术及研磨技术

市场

晶圆市场规模超过1兆日元 未来规模将进一步扩大

业务内容 (4/5 公司的PRIME晶圆业务)

- 2019年, 与中央政府直属企业北京有色金属研究总院(现为有研科技集团有限公司)合资, 有研半导体材料有限公司^{※1} (GRITEK) 作为合并子公司发展半导体业务。中国山东旗舰工厂竣工



※1现:有研半导体硅材股份有限公司

业务内容 (5/5 半导体相关设备/部件等业务)

- 硅和石英耗材的制造和激光二极管和半导体制造的检测设备的销售



2024年12月期第3季度 決算概況

02

2024年12月期第3季度 决算概况



•销售额同比增长12.8%，达到44,554亿日元，营业利润同比增长0.9%，为6,082亿日元

(百万日元)

	2023年12月 第3季度	2024年12月 第3季度	去年同期相比	差额
销 售 额	39,470	44,554	+12.8%	+5,084
营 业 利 润	9,576	9,669	+0.9%	+93
营 业 利 润 比 率	24.3%	21.7%		△2.6pt
经 常 利 润	12,017	11,075	△7.8%	+942
经 常 利 润 率	30.4%	24.8%		△5.6pt
归属于母公司股东 当期净利润	5,965	5,593	△6.2%	+372
每 股 净 收 益	226.82円	212.16円	△6.4%	△14.66円

2024年第3季度 细分化业务趋势



- 晶圆再生业务受三本木和台南工厂的增产投资的影响, 对比上年同期, 实现增收增益的推进
- PRIME晶圆业务由于提高生产效率等措施, 利润率上升
- 半导体相关设备·部件等业务受第一季度大额交易的影响, 对比上年同期, 实现销售额和利润的增长

(百万日元)

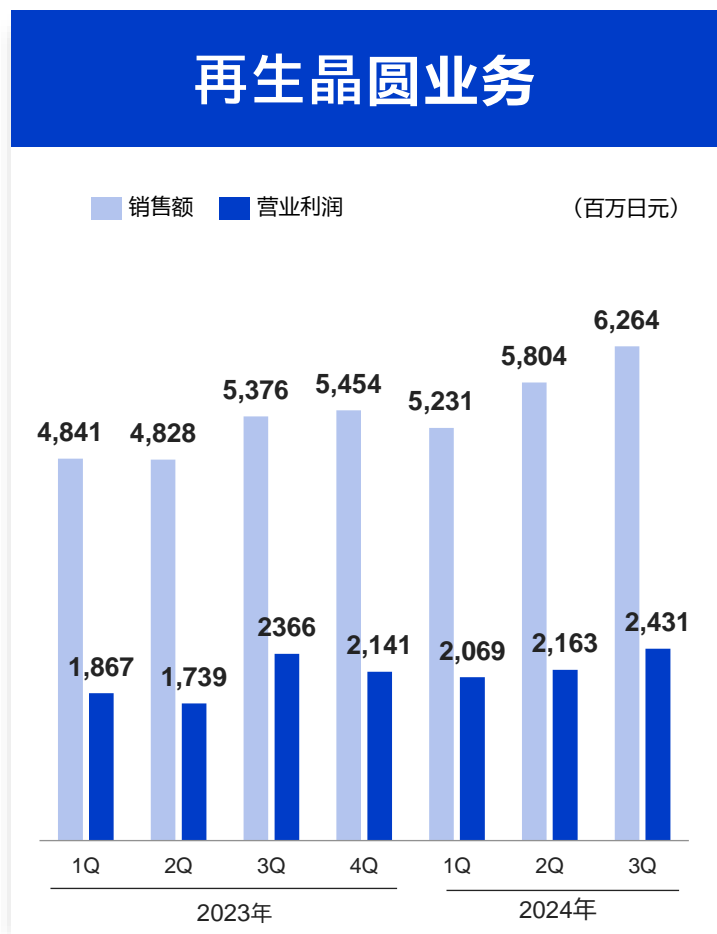
	再生晶圆业务		PRIME晶圆 制造销售业务		半导体相关设备· 部件等业务		其他, 调整金额		合并总计	
		同比		同比		同比		同比		同比
销 售 额	17,299	+14.9%	15,752	+3.4%	12,534	+22.2%	△1,031	—	44,554	+12.8%
营 业 利 润	6,663	+11.5%	3,767	+10.1%	484	△42.1%	△1,246	—	9,669	△0.9%
营业利润率	38.5%	△1.2pt	23.9%	+1.5pt	3.8%	△4.3pt	—	—	21.7%	△2.5pt

2024年第3季度 细分化业务趋势季度业绩图

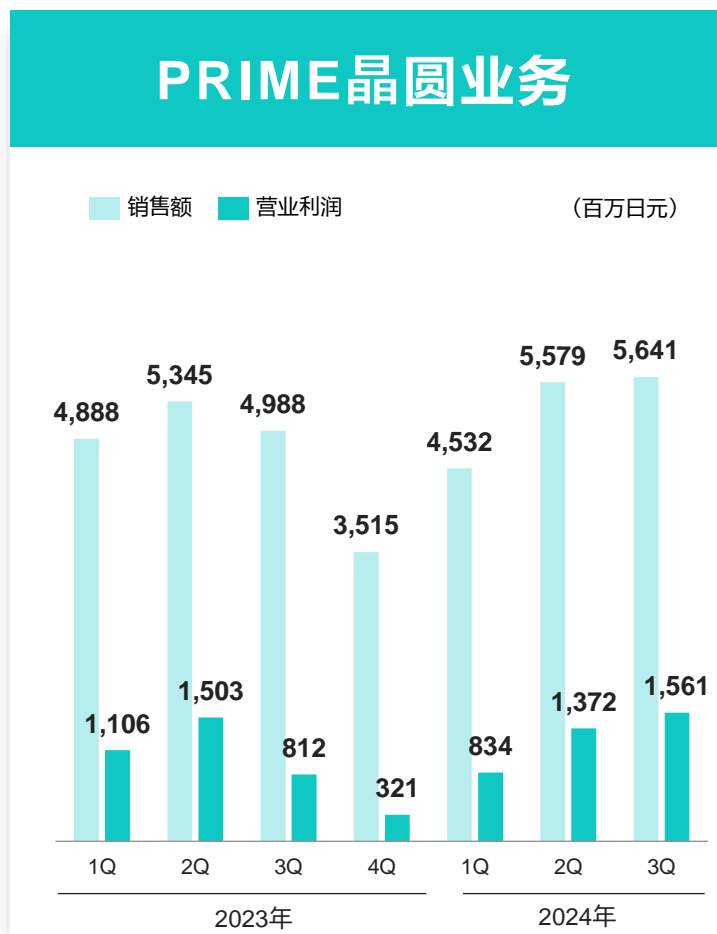


- 受增产投资效果的影响，晶圆再生业务的出货量对比上季度增加。营业利润率为38.8%
- PRIME晶圆业务中，面向8英寸功率半导体的主力商品单价上涨。营业利润率为27.6%
- 半导体相关设备·部件等业务，受商社业务中某些特定商品的销售下滑影响，对比上季度销售额及利润下降。营业利润为0.9%

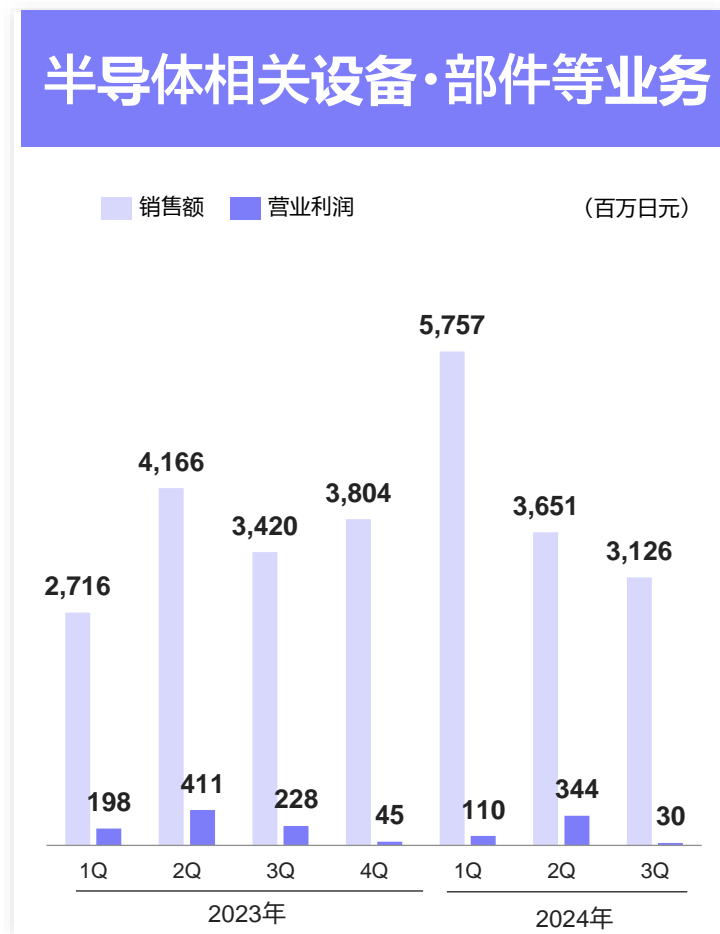
再生晶圆业务



PRIME晶圆业务



半导体相关设备·部件等业务



·净资产同上年末增加了146亿日元, 达到1300亿日元 (上年为1154亿日元)

(百万日元)

合并资产负债表	2023年12月	2024年12月 第3季度
流动资产	96,409	104,605
现金和存款	70,758	77,802
应收票据和应收账款	12,673	17,107
商品及产品	6,507	3,557
固定资产	44,256	50,841
有形固定资产	35,326	41,139
无形固定资产	266	277
投资其他资产	8,663	9,424
资产总计	140,666	155,446
流动负债	18,265	18,275
应付票据及应付账款	5,174	6,265
有息负债	3,355	3,625
固定负债	6,973	7,122
长期借款	2,092	1,561
负债合计	25,238	25,397
净资产	115,428	130,049
负债与净资产合计	140,666	155,446

中期经营规划

03

中期经营规划 (2024-2026) 概况 (基本规划)



- ◆虽然预计 2024 年上半年半导体市场仍将停滞不前,但从下半年开始有望走向复苏,预计销售额将超过 2023 年的水平
- 在再生晶圆业务方面,将继续对日本、台湾和中国的三个基地进行设备投资,以提高产能
- 在PRIME晶圆业务方面,将继续进行设备投资,以提高 8 英寸和 12 英寸晶圆在中国的市场份额
- 在半导体相关设备和部件业务方面,销售活动的目标是开发新市场和获取新客户

基本规划 * 1

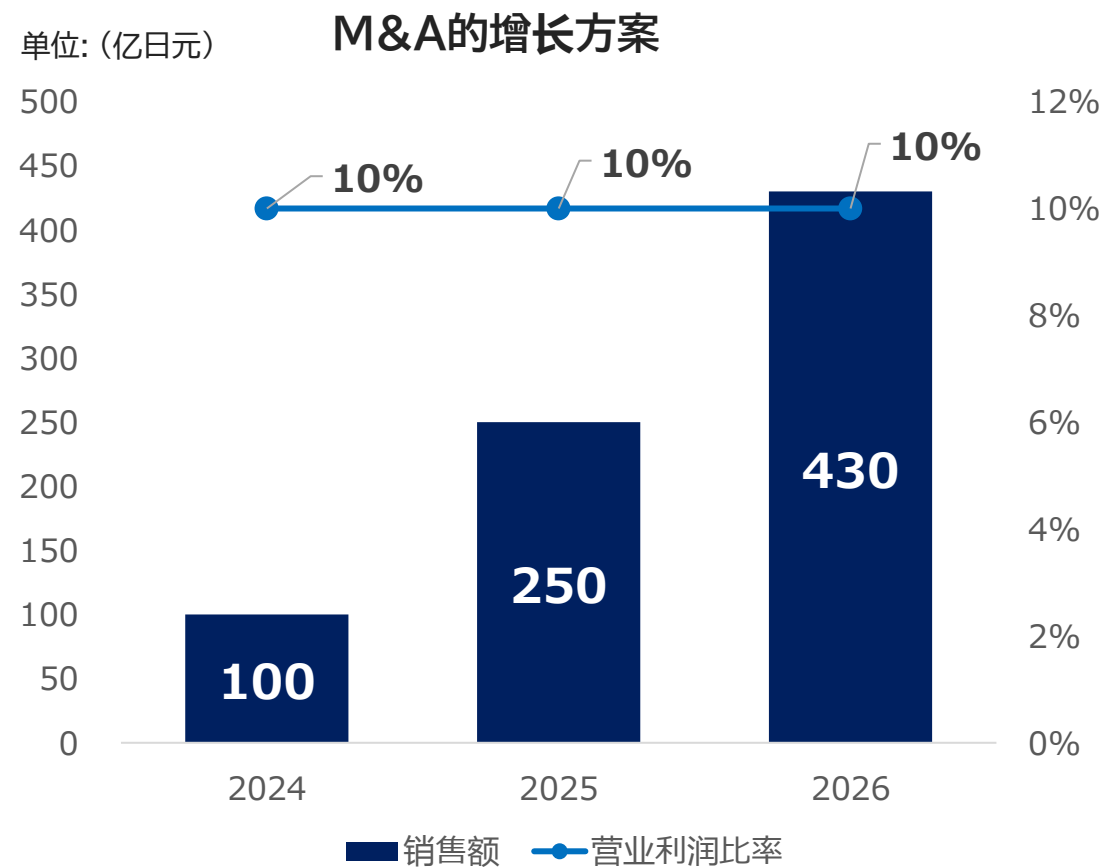
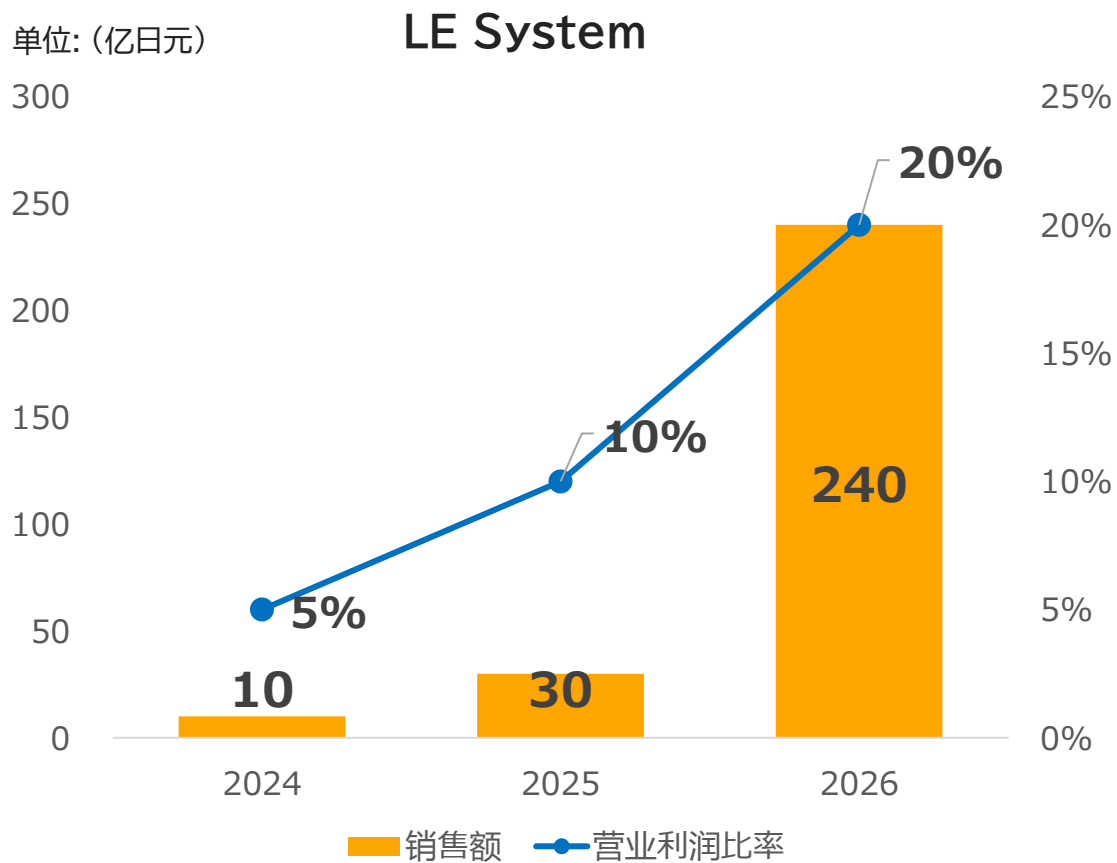
*1:现有3个业务(再生晶圆业务, PRIME晶圆业务, 半导体设备相关材料业务)的中期管理计划

(百万円)	2023年 12月期 (実績)	2024年 12月期計画	2025年 12月期計画	2026年 12月期計画
売上高	51,893	54,900	59,300	64,100
成長率		106%	108%	108%
営業利益	11,894	14,000	15,330	16,830
営業利益率	22.9%	25.5%	25.9%	26.3%
經常利益	14,921	15,400	16,730	18,230
經常利益率	28.8%	28.1%	28.2%	28.4%
当期純利益	7,703	7,600	8,200	8,800

中期经营规划 (2024-2026) 概况 (上行规划--目标值) 1/2



- ◆除了“基本规划”之外，还制定是上行规划目标。预计通过 LE System和M&A来实现增长
- LE System进入全钒液流电池最大的中国市场。目标设定为销售额240亿日元，营业利润率20%
- 通过M&A，公司将在3年内实现约430亿日元的销售额，并加速业务扩张



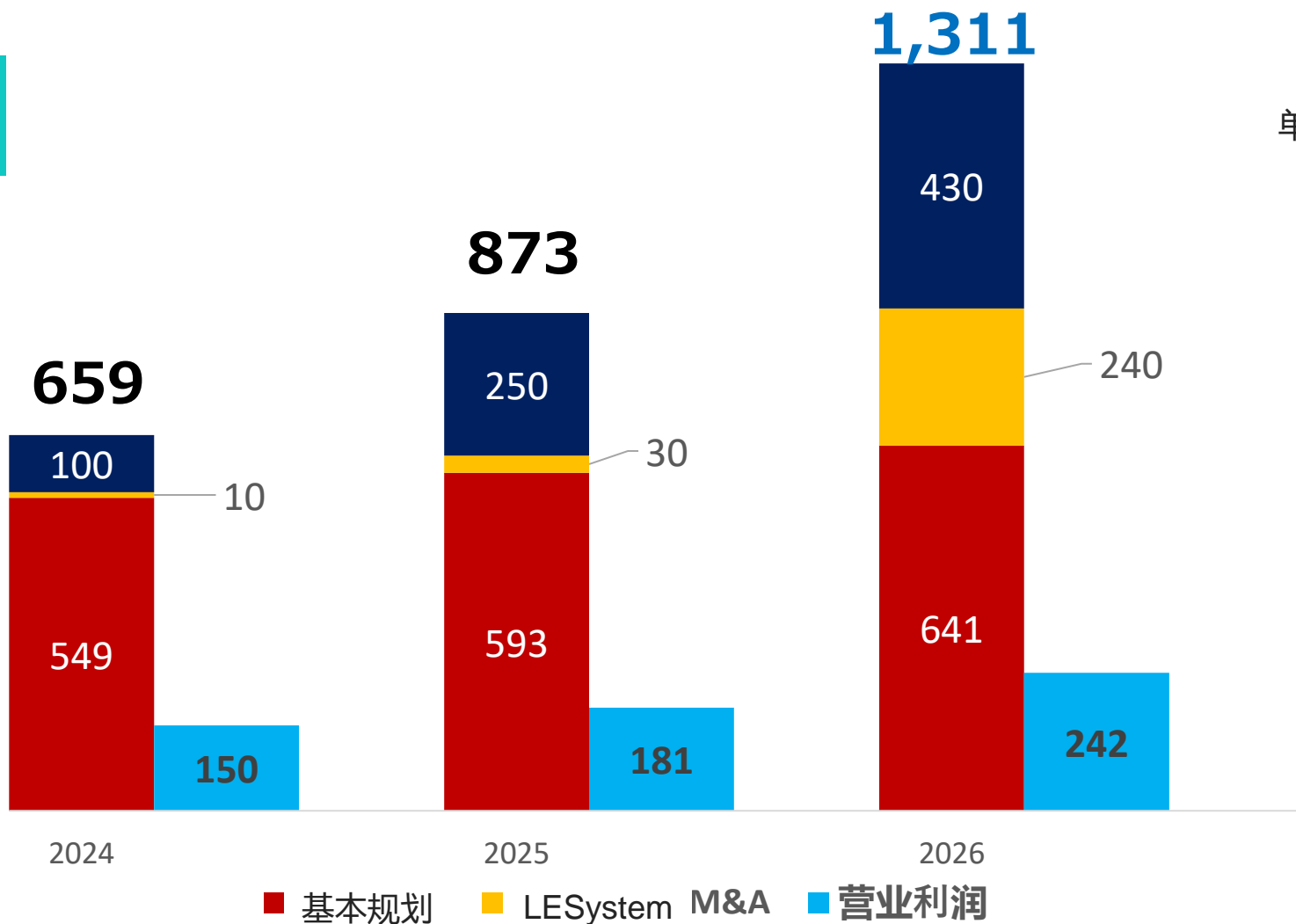
中期经营规划 (2024-2026) 概况 (上行规划-目标值) 2/2



- 到2026年将销售额设定为约1,300亿日元作为“上行规划 (目标值)”
- 在2024-2026的3年内, 通过LE System和M&A促进规模扩大

上行规划
(目标值)

单位: (亿日元)



关于在中国设立子公司 (投资性公司) 的通知

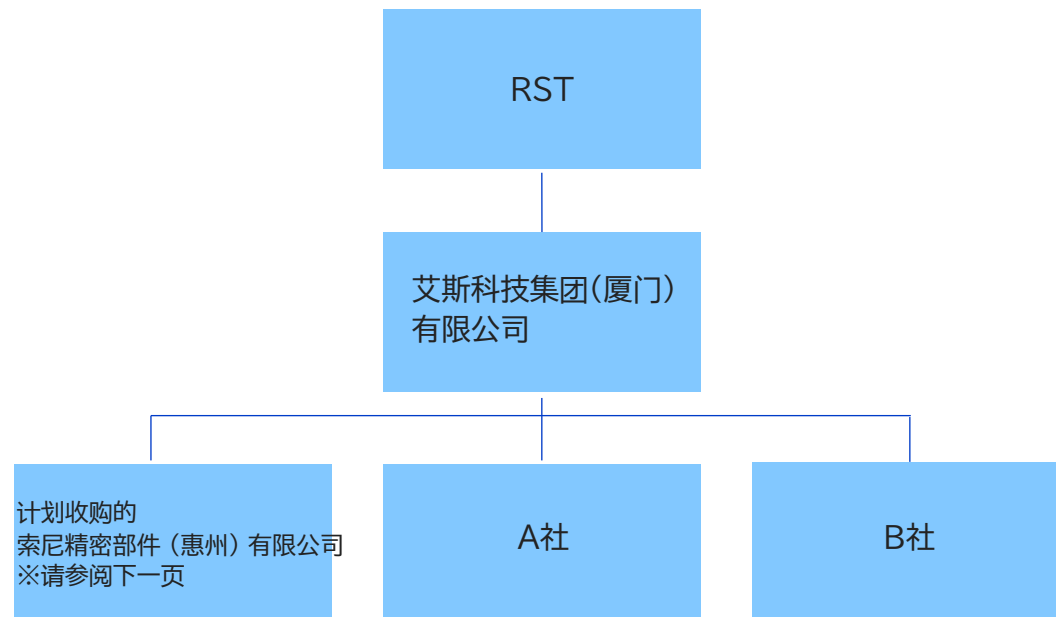


- 决定在中华人民共和国厦门市设立子公司 (投资性公司) 艾斯科技集团 (厦门) 有限公司 (暂称) (将于2024年10月24日公开)
- 投资性公司设立后, 计划通过设立新公司和投资业务, 扩大在中国的市场份额

<艾斯科技集团 (厦门) 有限公司的概要>

地址	中华人民共和国福建省厦门市海沧区
代表人	董事长 方永义
事业内容	对中国企业及本集团公司的投资、对投资方的经营管理、指导等
缴纳资本金	40,000,000USD (约2亿8480万 RMB按1 USD=7.12 RMB换算) (约60亿2960万 JPY按1 USD=150.74JPY换算)
设立年月日	预计2024年11月

<艾斯科技集团 (厦门) 有限公司的计划>



关于由RS Technologies即将新成立的中国公司 收购索尼精密部件(惠州)有限公司所有股权的通知



- 索尼精密部件(惠州)有限公司将于2024年12月30日成为子公司(2024年9月19日公开)
- 在现有业务光学拾取器模块的基础上,新设立车载相机模块业务,以进一步扩大业务。
- 利用本公司在中国市场的优势,有望扩大销路

<索尼精密部件(惠州)有限公司的概要>

会社名	索尼精密部件(惠州)有限公司
设立	1995年11月20日
资本金	5.55亿元
业务内容	光学拾音头模块和车载摄像头模块的生产和销售业务
地址	广东省惠州仲恺高新区惠环町惠风东一路9号11号



设备投资规划:再生晶圆业务



- 随着全球对半导体需求的扩大,日本和台湾的产量继续扩增,并在中国山东省开始量产
- 预计到 2026 年可建立89万片/月以上的晶圆生产能力,以满足强劲的需求

日本

总投资额

30亿日元

2024年

2亿日元

2025年

13亿日元

2026年

15亿日元

- 扩大12英寸再生晶圆的生产能力及微细化响应
- 2024年至2026年:每月产量增加4万片

■ 12英寸再生晶圆生产能力(月产)

2023年

31万片

2024年

32万片

2025年

34万片

2026年

36万片

台湾

总投资额

60亿日元

2024年

10亿日元

2025年

15亿日元

2026年

35亿日元

- 扩大12英寸再生晶圆的生产能力及微细化响应
- 2024年至2026年:每月产量增加7万片

■ 12英寸再生晶圆生产能力(月产)

2023年

23万片

2024年

26万片

2025年

28万片

2026年

33万片

中国

总投资额

61亿日元

2024年

1亿日元

2025年

30亿日元

2026年

30亿日元

- 扩充12英寸再生晶圆的生产能力
- 2024年至2026年:每月产量增加15万片

■ 12英寸再生晶圆生产能力(月产)

2023年

5万片

2024年

5万片

2025年

15万片

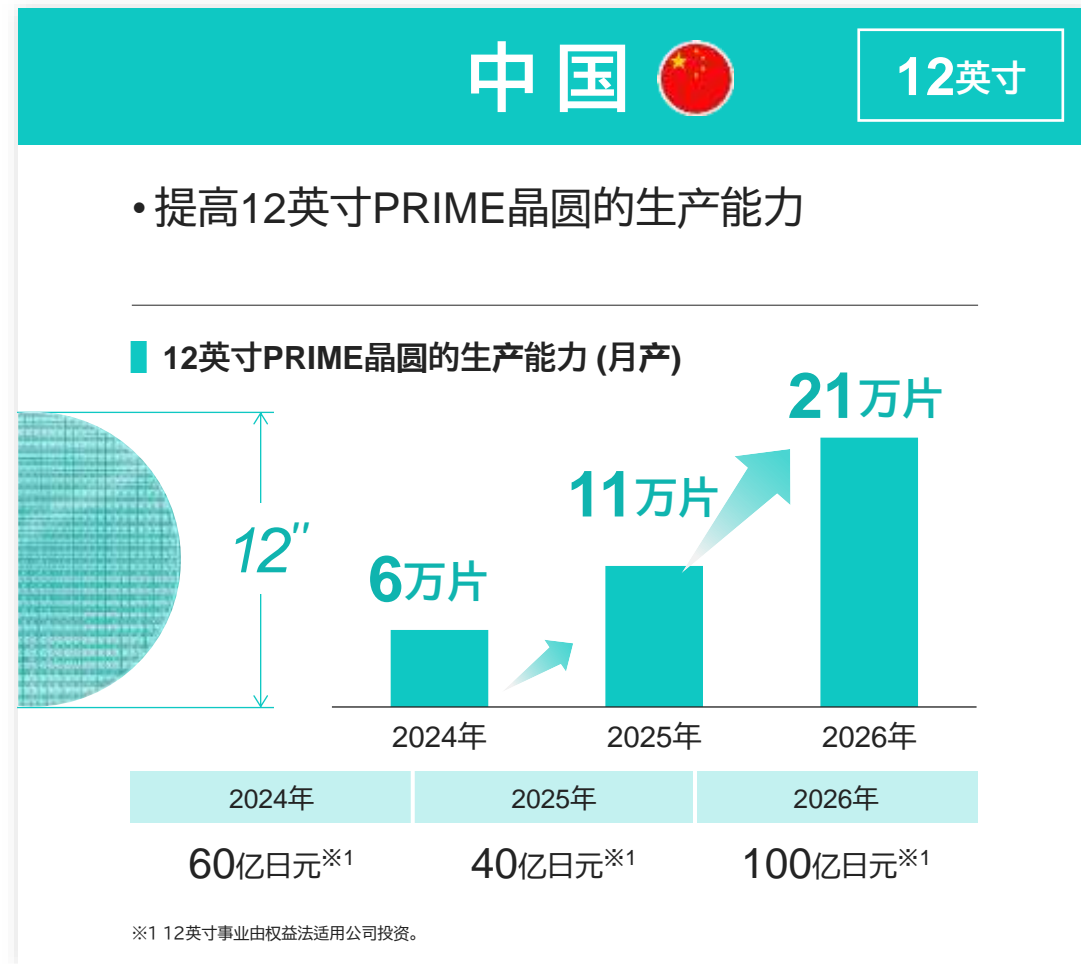
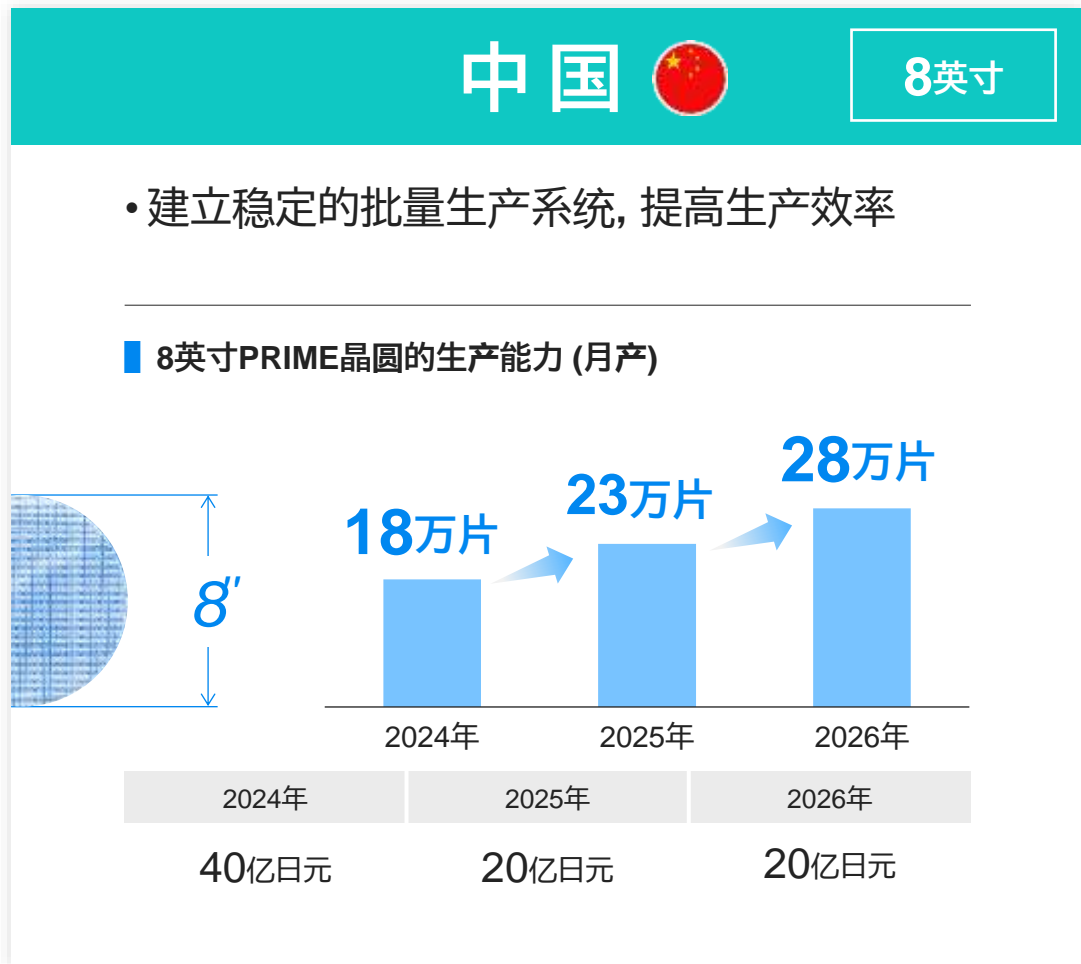
2026年

20万片

设备投资规划:PRIME晶圆业务



- 8英寸PRIME晶圆规划在2024年至2026年间从每月18万片增加到28万片
- 12英寸PRIME晶圆规划在2024年至2026年间从每月6万片增加到21万片

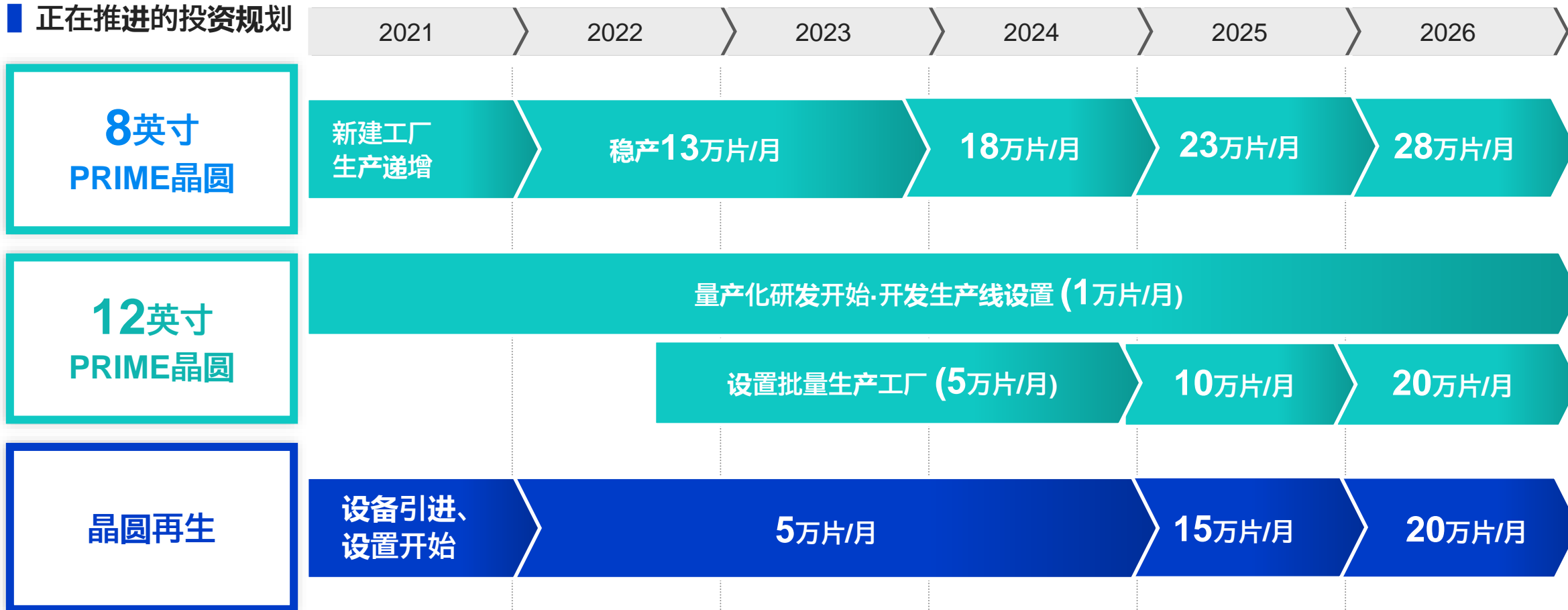


中国投资规划（时间线）



- 8英寸PRIME晶圆从每月13万片增加到18万片
- 12英寸PRIME晶圆将设置月产5万片的量产生产线, 力争早日实现高品质、稳定生产
- 再生晶圆业务继续每月批量生产5万片

正在推进的投资规划



再生晶圆业务的需求:12英寸半导体“新”工厂

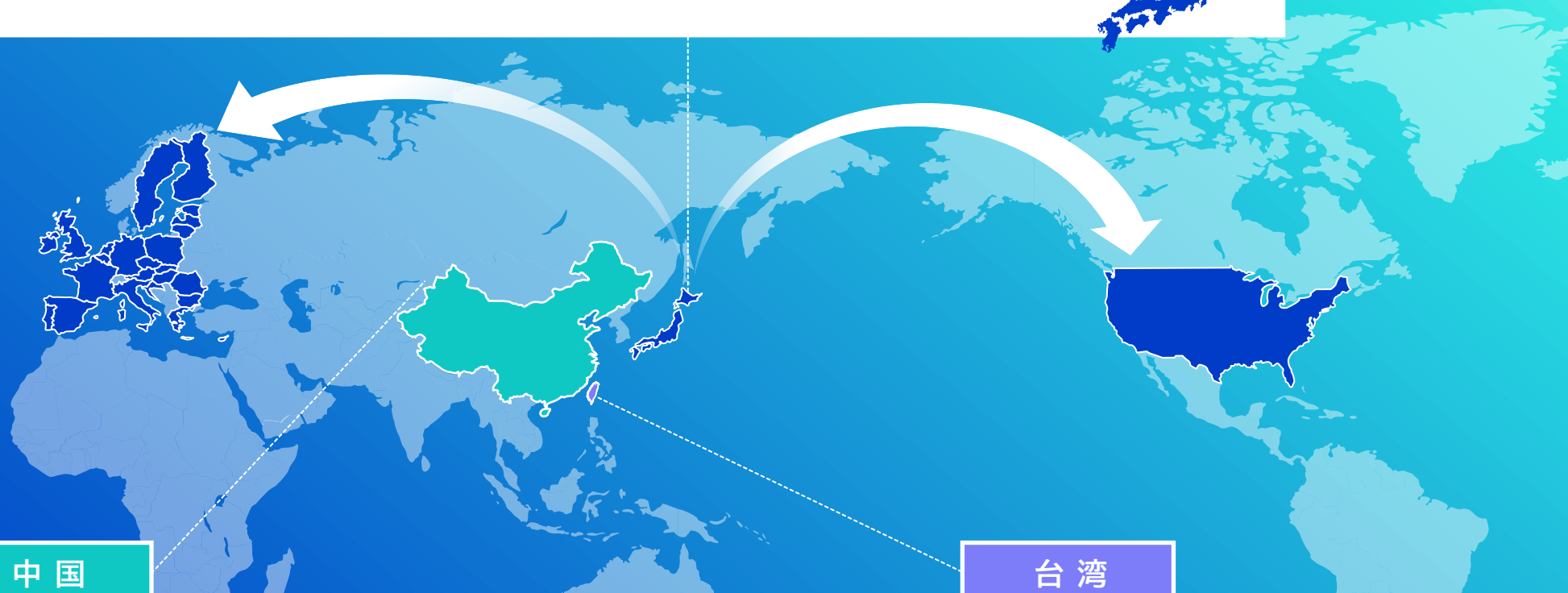
- 在全球市场上, 中国、欧洲、美国、日本和其他地区都在建设新的 12 英寸半导体工厂
- 公司在日本、台湾和中国进行设备投资, 以应对再生晶圆的新需求



地域战略 不受脱钩影响的地域战略

日本、北美、欧洲

三本木工厂 (日本旗舰工厂) 主要覆盖北美, 欧洲, 日本等地



中国

目前PRIME晶圆
主要销往中国



台湾

代工厂的聚集地
台湾地区由台湾工厂覆盖



新业务

LE System

04

- 2023年12月，株式会社 LE System (公司的全资子公司) 从旧LE System 承接了全钒液流电池 (VRFB)所使用的电解液业务

■ 新公司概况



公司的名字	株式会社 LE System
设 立	2023年10月13日 (业务承接日期:2023年12月)
业 务 内 容	全钒液流电池电解液的制造
所 在 地	东京都品川区大井1-47-1NT大楼 (位于株式会社 RS Technologies内)
制 造 基 地	福岛县浪江町
资 本	30百万日元
董 事 长	方永义

- 自2023年12月起, 全面接管旧LE System的业务
- 旧LE System的核心技术是诞生于日本的技术, 得到了包括株式会社 INCJ (官民基金) 投资在内的很多支援

■ LE System的优势



高质量电解液
已建立批量生产工艺



与海内外众多电池制造商开展
全球合作



通过专有技术降低成本
实现生产 (拥有10多项专利)

什么是全钒液流电池 (VRFB)



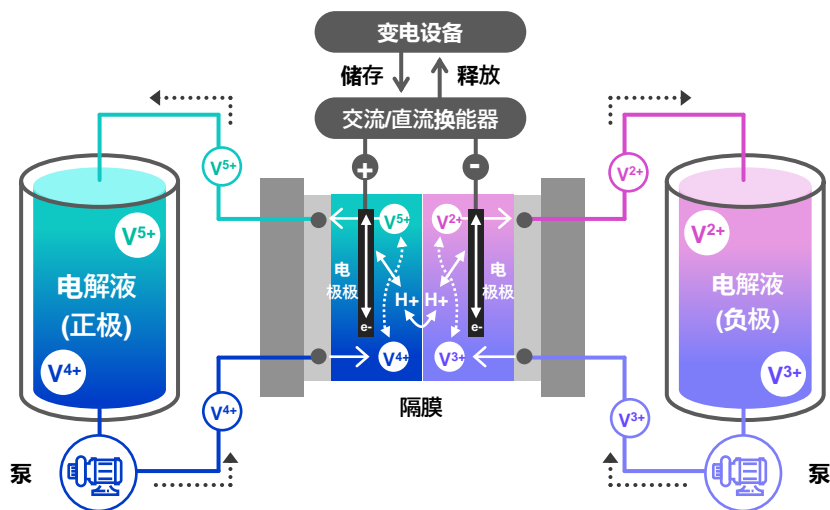
- VRFB是一种蓄电池, 通过钒电解液的循环和化学反应进行充放电; LE System生产和供应这种钒电解液

主要用途

用作大型、大容量固定式蓄电池, 例如用于风能和太阳能发电

结构

与其他蓄电池通过电极的化学变化进行充电和放电相比, VRFB通过电解液的化学变化 (氧化还原) 实现充放电



特征

充电和放电次数没有限制, 没有劣化, 因此可以长期稳定运行, 安全性高, 与再生能源的兼容性好



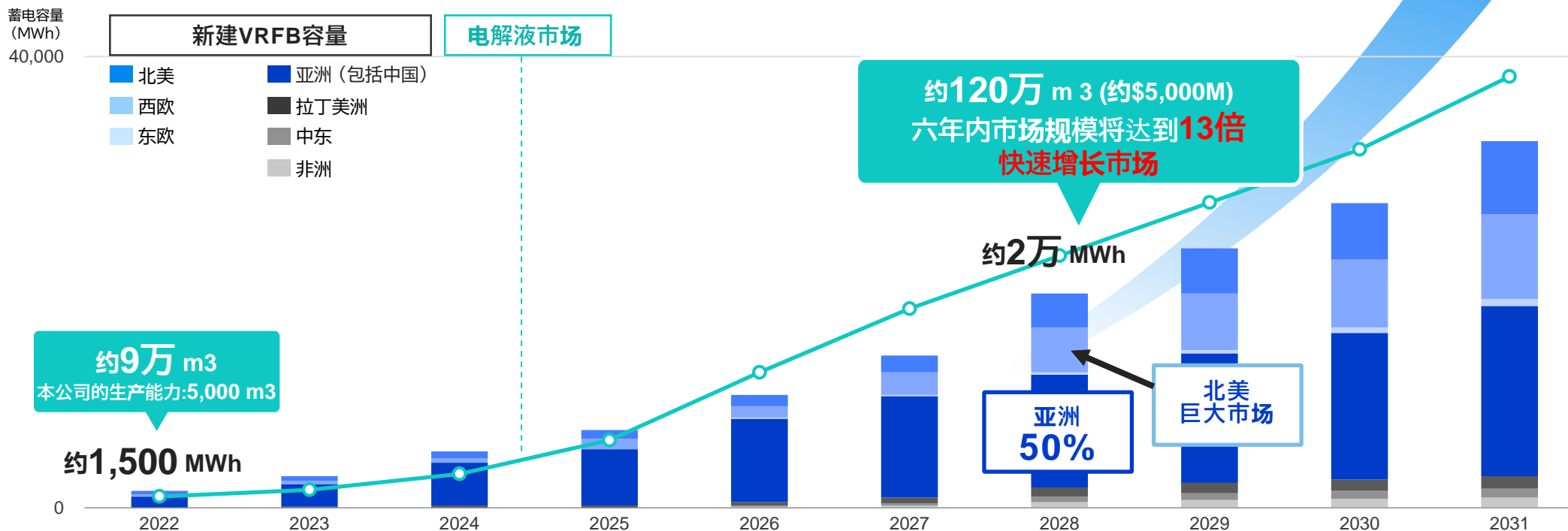
VRFB作为大容量的固定式蓄电池, 具有高安全性和稳定供给的风力、太阳能发电等最适合的特征

全钒液流电池 (VRFB) 的市场规模



- 预计VRFB市场将在2028年扩大至目前的10倍以上
与此同时, 电解液的需求也有望增长

■ 新建VRFB容量 (按世界/地区) 和电解液市场预测



新LE System中将活用公司的海外网络 (特别是我们在亚洲(包括中国)的优势),
我们的目标是到2028年实现获得全球市场占有率第一

- 成立于2023年10月的LE System生产用于氧化还原钠流电池 (VRFB) 的电解液
- 从2024年开始, 我们将在全球范围内全面营业活动以扩大业务规模

LE System的捕获

- 自公司设立以来, "再生"一直是我们的业务发展的关键词
- LE System符合公司“再生”经营理念的业务模式, 有望在未来实现增长
 - 1) 可再生能源领域有望快速增长
 - 2) 回收利用石油等物质产生的残渣提炼钒电解液的生产技术
 - 3) 电解液本身也可以回收利用

未来增长战略

- 中国的国策是将VRFB打造成继锂离子电池之后的第二大支柱产业, 中国将成为其未来最大的市场
- 利用LE System专利技术的成本竞争力和公司在中国的业务平台, 力争在中国的VRFB市场上占据最大份额
- 公司将继续投资日本的研发基地
- 当日本对大容量固定式蓄电池的需求增加时, 公司将建立一个可以在日本批量生产的系统

Appendix

05

董事长 方永义的优势

- 董事长永义灵活运用20多年来在日本累积的见识和广泛人脉, 并拥有面向

全球的销售能力、人际关系、合作能力、资金实力

- 方永义麾下集结了高科技、金融等广泛领域的专业人才



方永义 (HO NAGAYOSHI)

- 1970年出生于中国福建省
- 城西国际大学 经营学博士
- 1998年永辉商事成立
- 2010年本公司成立就任社长(现任)
- 2014年加入日本国籍

■ 擅长的领域

M&A, 业务合作

■ 座右铭

有志者事竟成

■ 补充

- 高中毕业后赴日。除半导体业务以为, 还有基金, 贸易, 酒店, IT, 农业等各种行业的投资经验
- 以“日本的制造服务世界第一”为信条, 奔走于世界各地, 向全球推广日本的制造服务。

三本木工厂 (RS Technologies、再生晶圆业务)



- 2011年1月, 开始运作
- 2015年6月, 引进最先进设备的第8工厂开始生产



公司的名	株式会社 RS Technologies
设立	2010年12月
产品	5、6、8、12英寸再生晶圆
生产能力	8英寸 :月产15万片 12英寸:每月31万片
所在地	宫城县大崎市
认证	ISO9001、ISO14001

台南工厂 (RSTW、再生晶圆业务)



- 2015年12月, 艾尔斯半导体股份有限公司 (RSTW) 台南工厂开始生产



公司的名	艾尔斯半导体股份有限公司
设立	2015年12月
产品	12英寸再生晶圆
生产能力	12英寸:每月23万片
所在地	台湾台南市
认证	ISO9001、ISO14001

德州工厂 (山东GRITEK8英寸PRIME晶圆业务)



- 2018年8月, 设立山东有研半导体材料有限公司 (GRITEK的连结子公司、山东GRITEK)
- 2020年10月, 新工厂完成竣工,作为新的PRIME晶圆的生产据点开始运行



公司的名	山东有研半导体材料有限公司
设立	2020年10月
产品	5、6、8英寸PRIME晶圆
生产能力	5英寸:每月5万片 6英寸:每月20万片 8英寸:每月13万片
所在地	中国山东省德州市
认证	ISO9001、ISO14001

SGRS研发中心 (SGRS12英寸PRIME晶圆业务)



- 2020年3月, 设立山东有研RS半导体材料有限公司(SGRS)
- 2021年设置了月产1万片的试验线



公司的名	山东有研RS半导体材料有限公司
设 立	2020年3月
产 品	① 12英寸PRIME晶圆 ② 12英寸再生晶圆
生 产 能 力	① 月产5万片, 开发生产线月产1万片 ② 月产5万片
所 在 地	中国山东省德州市 中国北京市

浪江工厂 (株式会社LE System, 可再生能源业务)



• 2023年12月, 公司完成了承接旧LE System的**电解液制造业务**^{*1}

※1旧LE System的核心技术是诞生于日本的技术, 得到了包括株式会社 INCJ (官民基金) 投资在内的很多支援



福岛县浪江町的电解液工厂(2021年建成。每年批量生产5,000m³)



茨城县筑波市的事业所
(2013年建成。技术研究/试验工厂)

公司的名	株式会社LE System
设立	2023年10月13日 (业务继承日期:2023年12月)
业务内容	全钒液流电池的电解液制造
生产能力	约5,000m ³ /年
所在地	福岛县浪江町 (工厂) 茨城县筑波市 (事务所)

神栖工厂 (DG Technologies、半导体相关设备、·部件等业务)



- 2019年1月, DG Technologies成为合并子公司
- 为应对不断扩大的需求, 正在实施通过设备投资和生产性改善来增加产量的战略



公司的名字	株式会社DG Technologies
设立	1981年10月
产品	干式刻蚀装置 石英、硅耗材
所在地	茨城县神栖市
认证	ISO9001

栗原工厂 (DG Technologies、半导体相关设备, 部件等业务)

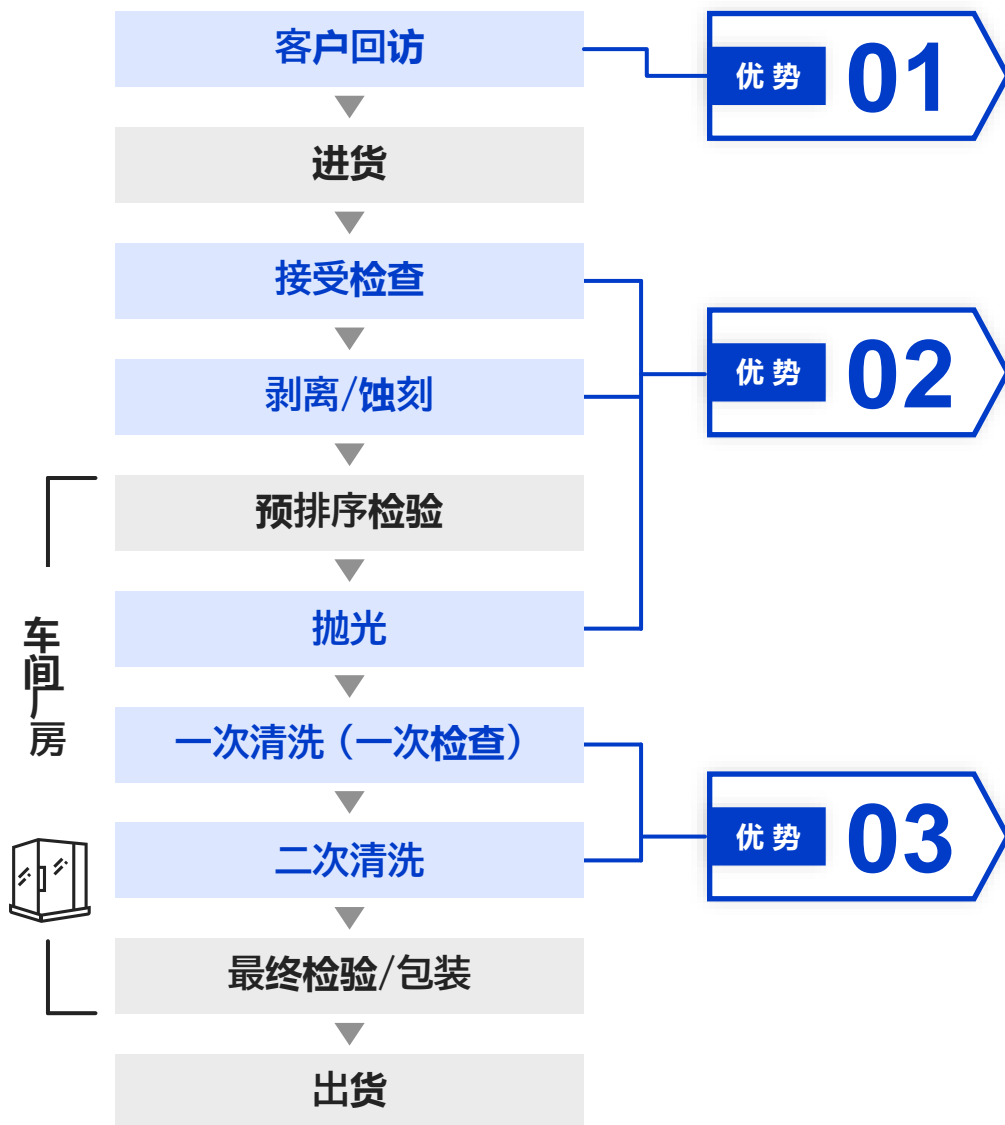


- 2021年5月, 在宫城县开设了栗原工厂
- 通过神栖工厂和栗原工厂 (新成立) 这两个传统的生产基地, 公司将响应增加的订单



公司的名字	株式会社 DG Technologies
开始运行	2021年5月
产 品	干式刻蚀装置 石英、硅耗材
所 在 地	宫城县栗原市
建筑 面积	5,000m ²

晶圆再生业务 (1)



通过直销系统准确了解需求

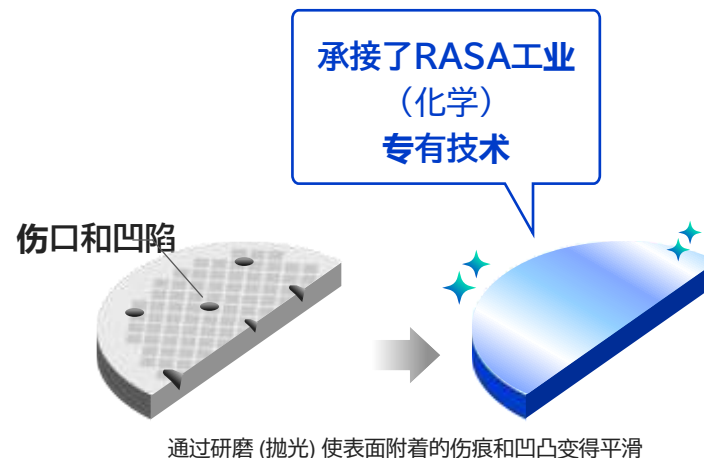
与所有客户进行直接沟通，
通过在东京总部管理实现压倒性的成本降低

可剥离所有薄膜

因为是化学处理，所以表面损伤最小

再生次数多

可以进一步降低成本

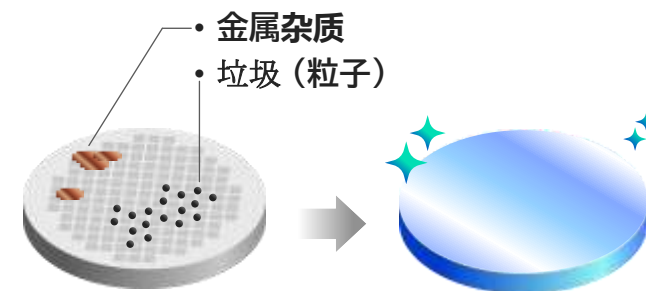


去除金属杂质

通过清洗去除晶圆表面的微小垃圾和污垢

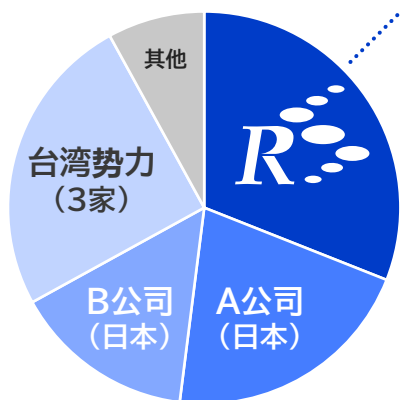
去除金属杂质

特别是在铜 (Cu) 去污去除方面的优势



扩大公司在再生市场的份额

公司在12英寸再生市场的份额



RS Technologies

由于增设了台湾工厂和三本木工厂，生产能力提高了，目前的市场份额已上升到约33%

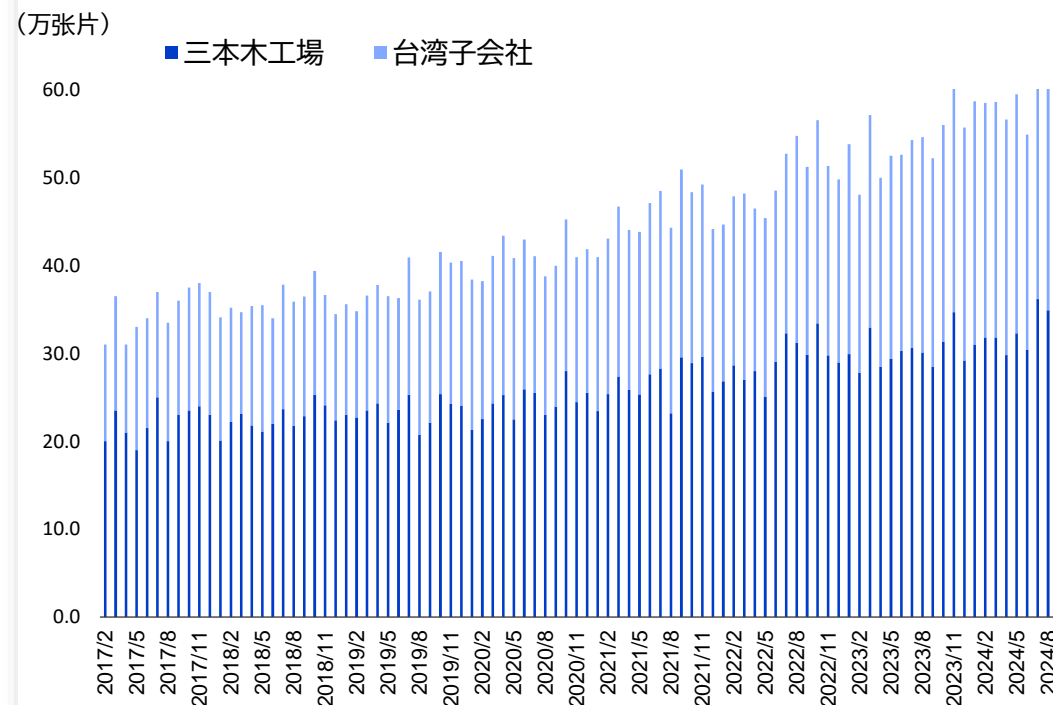
旨在通过利用两家工厂的现有设施提高生产力，利用三本木的空工厂，业务合作和并购等方式进一步扩大市场占有率

年	2015下半年	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
生产能力	24万片	28万片	30万片	34万片	40万片	42万片	46万片	55万片	59万片
份额	24%	29%	30%	31%	33%	33%	33%	33%	33%

我们公司根据SEMI数据估算

三本木工厂和台湾子公司的出货趋势

三本木工厂和台湾子公司12英寸晶圆出货量趋势



进军PRIME晶圆领域



- 与中国中央企业※1的有研科技集团有限公司 (GRINM) 设立合资公司半导体材料有限公司*2 (GRITEK)

公司与有研的协同效应

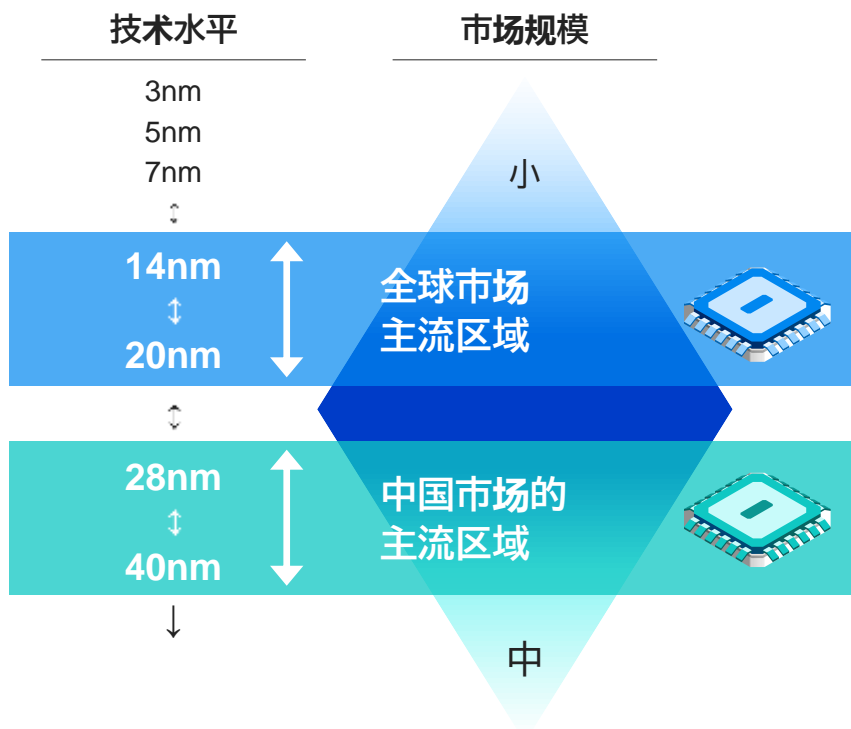


※1 国有企业中受中央政府监管的企业
※2现:有研半导体硅材股份有限公司

12英寸原片市场策略

- 确保中国主流区的质量, 利用M&A等手段实现中国市场占有率第一
- 在实现中国市场占有率第一的同时, 实现全球品质, 向晶圆再生客户网 (半导体全球厂商) 进军开始销售, 目标是成为全球通用的PRIME晶圆制造商

半导体市场的技术水平和市场规模



中国PRIME晶圆业务的市场战略

■ 以确保全球质量为目标

- 质量 达到全球品质
- 价格 国产实现低价
- 销售 利用晶圆再生客户网
- ▶ 实施全球销售

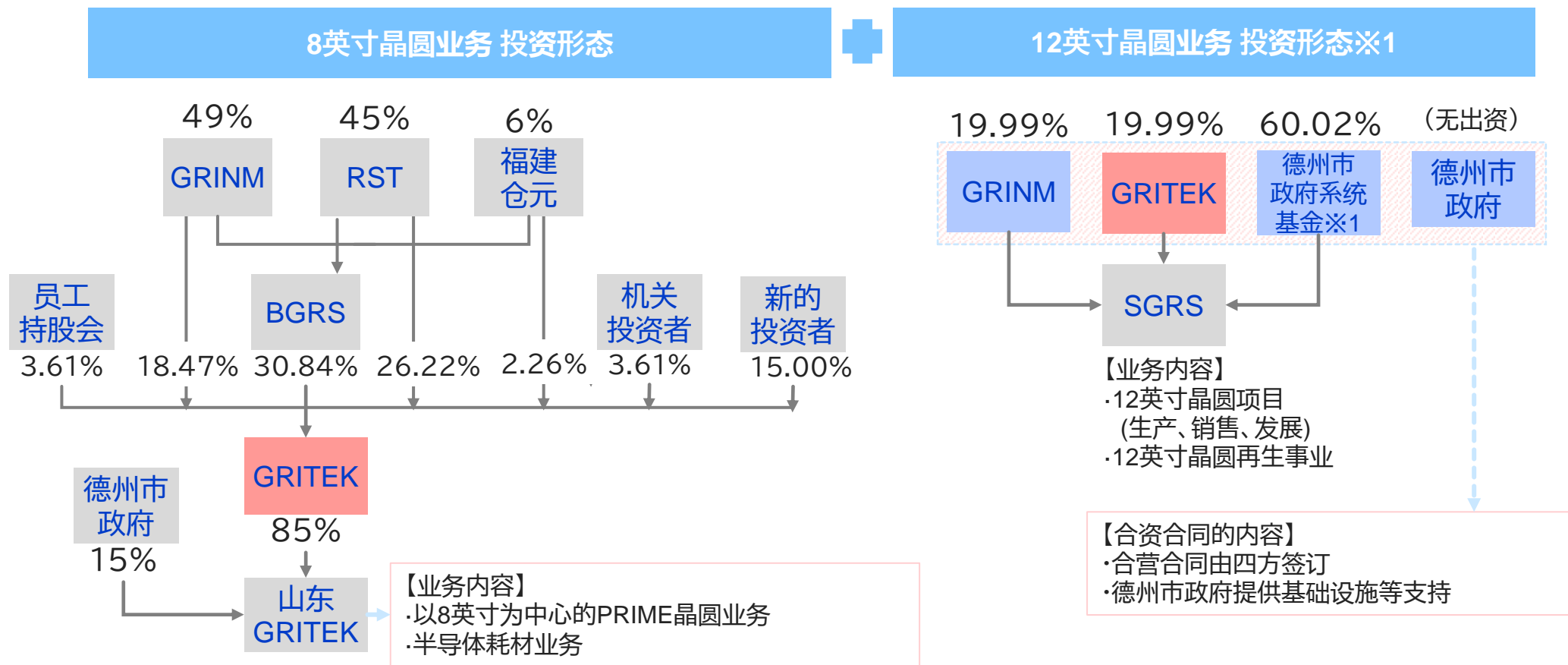
■ 12英寸PRIME晶圆的目标品质

- 质量 确保中国市场的主流区域质量
- 价格 利用M&A等以低成本取得设备实现低价
- ▶ 实现中国市场占有率第一

PRIME晶圆的投资方案



- GRITEK于上海证券交易所科创板上市 (SHA:688432)
- 因为本公司所以涉及可能的中国政府系基金的风险控制模型



※1德州汇达半导体股权投资基金合伙企业

关于公司在中国的合资伙伴 (GRINM)



成立于1952年

中国有色金属领域最大的国有研究机构

约4,100名员工中, 约有2,000名为研究人员

在中国约4500万家企业中, 国有企业有46万家

其中, 中央企业**98家**, GRINM系其中1家

政、工、学一体化的研究机构, 中央政府在有色金属领域的
方针是通过该公司传达的

研究结果升华为约30家综合研究机构和商业公司

与公司的合资公司**GRITEK**作为**业务公司第1号**成立, 并在
上海证券交易所上市

RS Technologies 的愿景

一步一步，稳步推进业务领域和
扩大销售区域

业务

增长

		日本	中国	亚洲 (中国以外)	欧美	
制 造	再生晶圆	●	●	●	●	
	PRIME晶圆	12in	○	●	○	○
		8in他	○	●	○	○
	半导体制造相关消耗品	●	●	●	●	
	半导体制造	○	○	○	○	
再 关 的 键 事 业	新建	○	○	○	○	
	全钒液流电池	●	○	○	○	
商 职 社 能	制造设备	●	●	●	●	
	半导体、电子元件、消耗品	●	●	●	○	
	其他 (光伏等)	●	○	●	○	

● 当前业务领域 ○ 地域扩展计划 ○ 今后进军的可能性

地域

(百万日元)	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
销售额	3,475	4,566	5,285	8,864	10,932	25,478	24,501	25,561	34,620	49,864	51,893
销售毛利	1,173	1,820	1,852	2,544	4,252	8,366	7,940	8,681	11,870	18,432	17,413
管理费	471	654	791	958	1,269	2,615	3,223	4,151	4,995	5,413	5,519
营业利润	703	1,166	1,061	1,585	2,982	5,751	4,717	4,530	6,874	13,018	11,894
经常利润	819	1,247	770	1,444	3,159	6,141	5,416	5,252	8,832	15,500	14,921
当期利润 (※1)	525	664	143	861	2,113	3,620	3,035	2,824	3,303	7,739	7,703
红利(日元) (※2)	-	-	-	10	5	10	15	20	25	35	30
设备投资	338	3,503	4,665	209	95	1,328	4,809	12,409	7,827	5,379	5,999
折旧费	87	103	326	682	714	1,298	1,814	1,674	2,942	3,498	3,774
研发费用	1	6	11	85	183	501	449	929	1,308	1,657	1,764
员工数 (正式员工) (人)	152	191	265	373	434	1,159	1,277	1,187	1,333	1,533	1,534

(※1) 归属于母公司股东的当期净利润 (※2) 2023年度的分红在2023年1月1日(1/2)分割后显示

主要财务报表



(100万日元)	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
资产部分											
流动资产	1,811	2,759	3,732	5,348	7,388	26,074	32,760	32,626	45,804	90,470	96,409
现金和存款	397	1,190	1,842	1,952	3,243	14,879	22,156	19,082	25,438	67,939	70,758
应收票据和应收账款	681	696	795	2,531	2,916	6,958	6,047	6,321	9,517	11,651	12,673
商品及产品	396	376	361	348	446	1,343	1,713	2,116	2,783	3,833	6,507
固定资产	508	4,064	5,845	5,333	4,843	10,516	15,873	26,124	33,206	37,084	44,256
有形固定资产	461	3,918	5,667	5,152	4,674	8,963	14,635	24,146	29,023	31,285	35,326
无形固定资产	19	15	29	23	19	1,099	732	527	417	270	266
投资其他资产	27	130	148	158	149	453	506	1,451	3,766	5,529	8,663
资产总计	2,320	6,823	9,577	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750	79,010	127,554	140,666
负债部分											
流动负债	960	2,292	2,295	2,993	3,370	4,979	7,252	12,631	14,171	17,622	18,265
应付票据及应付账款	138	151	186	283	398	1,554	1,614	2,871	4,317	6,466	5,174
有息负债	136	827	1,216	1,538	1,276	976	1,730	1,522	3,020	4,694	3,355
固定负债	709	2,934	4,798	4,317	3,335	2,474	5,400	5,754	9,827	8,458	6,973
长期借款	615	2,925	4,079	3,620	2,767	1,848	2,232	1,613	5,097	3,514	2,092
负债合计	1,670	5,227	7,093	7,310	6,705	7,453	12,652	18,385	23,999	26,081	25,238
净资产的部分											
净资产	649	1,596	2,483	3,371	5,526	29,137	35,981	40,365	55,011	101,473	115,428
负债与净资产合计	2,320	6,823	9,577	10,682	12,231	36,591	48,634	58,750	79,010	127,554	140,666

细分化业务的业绩趋势

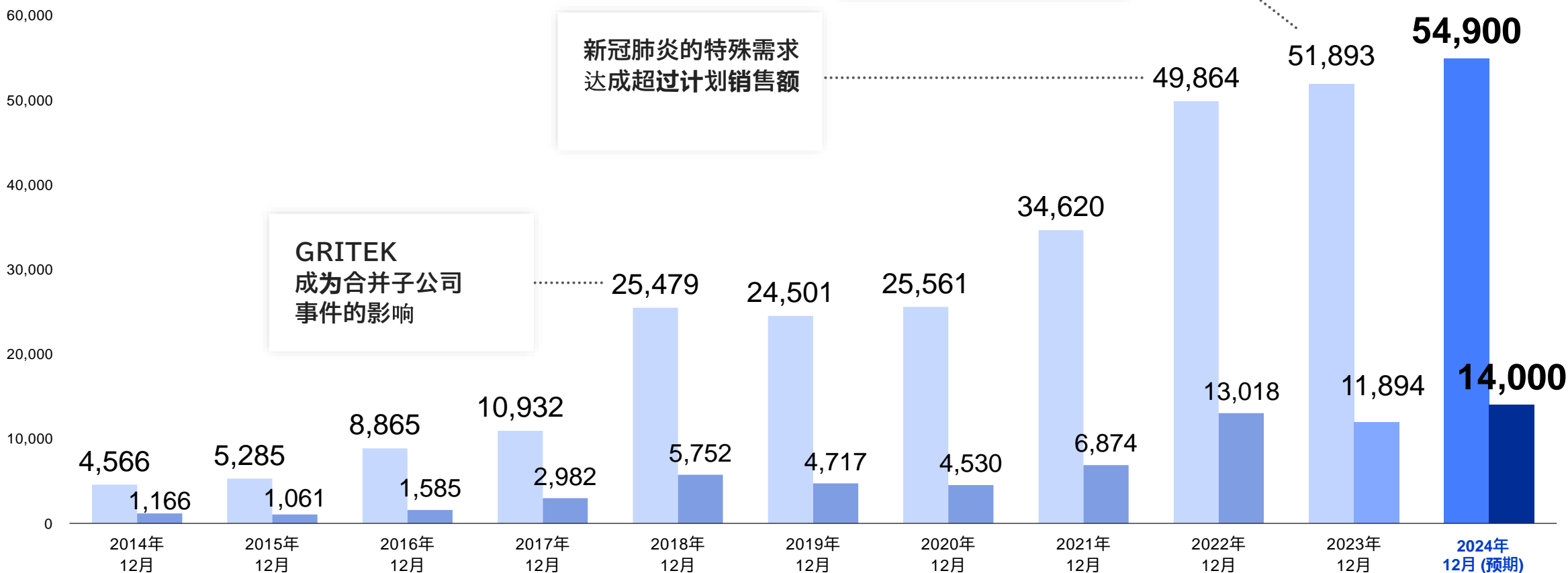


(百万日元)	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
销售额											
再生晶圆业务	3,347	4,414	5,107	7,144	9,487	10,973	10,776	11,461	12,717	18,001	20,499
PRIME晶圆生产销售业务	-	-	-	-	-	11,918	10,058	8,755	14,780	22,752	18,736
半导体生产设备的收购与销售	-	-	-	1,654	1,393	2,918	4,047	6,272	8,450	11,265	14,057
其他, 调整金额	127	151	178	66	52	△331	△380	△927	△1,327	△2,154	△1,399
细分化利润											
再生晶圆业务	916	1,444	1,377	1,765	3,396	4,011	4,081	4,027	4,731	7,312	8,114
金箔生产销售业务	-	-	-	-	-	2,048	1,503	1,041	2,539	5,995	3,742
半导体生产设备的收购与销售	-	-	-	230	130	366	171	211	382	914	882
其他, 调整金额	△214	△278	△316	△409	△543	△675	△1,038	△749	△778	△1,203	△844
细分化资产											
再生晶圆业务	1,337	5,040	6,987	5,657	8,120	9,150	10,336	11,698	14,302	18,530	21,833
PRIMR晶圆生产销售业务	-	-	-	-	-	21,313	29,311	35,697	53,202	95,788	100,768
半导体生产设备的收购与销售	-	-	-	1,137	1,305	1,939	3,179	5,387	7,310	6,801	8,775
其他, 调整金额	982	1,783	2,589	3,887	2,805	4,315	5,806	5,968	4,243	6,435	9,290

合并销售和营业利润

(百万日元)

■ 销售额 ■ 营业利润



不局限于上一期特殊需求使得销售额大幅增加,将持续增长

新冠肺炎的特殊需求达成超过计划销售额

GRITEK 成为合并子公司事件的影响

该资料记载的内容是根据一般公认的经济形势及公司认为合理的一定前提而制作的,但由于经营环境的各种变化,可能会在没有预告的情况下进行变更

本公告提供的材料和信息包括“前景信息”。这些信息基于当前的前景、预测和风险假设,并且实际上包含导致不同结果的不确定性

即使将来发生新信息和未来事件,公司不承担更新和修改本公告中包含的“预测信息”